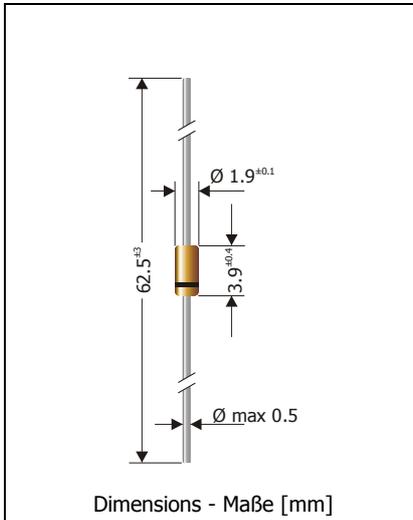


BAV19 ... BAV21**Superfast Switching Si-Planar Diodes
Superschnelle Si-Planar-Dioden**

Version 2012-07-03



Max. power dissipation Max. Verlustleistung	500 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrespannung	100...200 V
Glass case Glasgehäuse	~ DO-35 ~ (SOD-27)
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g
Equivalent SMD-version Äquivalente SMD-Ausführung	BAV100...BAV102
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	

**Maximum ratings (T_A = 25°C)****Grenzwerte (T_A = 25°C)**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrespannung V _{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrespannung V _{RSM} [V] ¹⁾
BAV19	100	120
BAV20	150	200
BAV21	200	250

Max. power dissipation Max. Verlustleistung	T _A = 25°C	P _{tot}	500 mW ²⁾
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	T _A = 25°C	I _{FAV}	250 mA ²⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I _{FRM}	650 mA ²⁾
Peak forward surge current, t ≤ 1 s Stoßstrom, t ≤ 1 s	T _A = 25°C	I _{FSM}	1 A
Peak forward surge current, t ≤ 1 μs Stoßstrom, t ≤ 1 μs	T _A = 25°C	I _{FSM}	5 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j T _s	-50...+200°C -50...+200°C

1 Tested with pulses I_R = 100 μA, t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2%

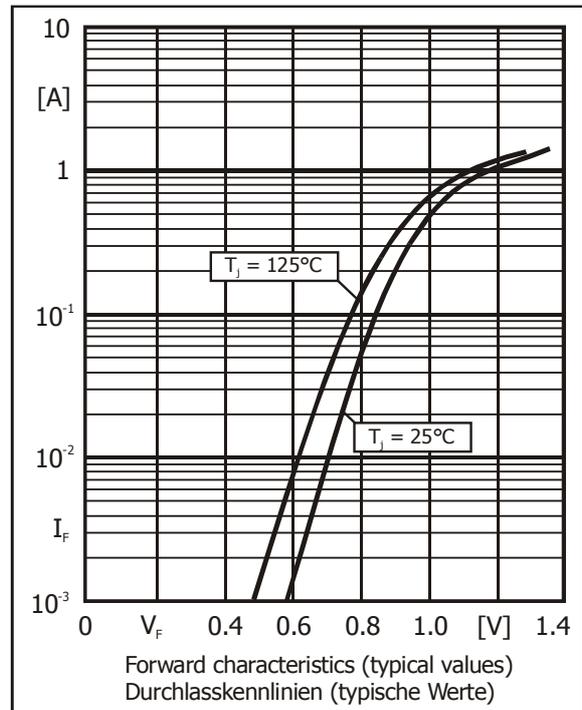
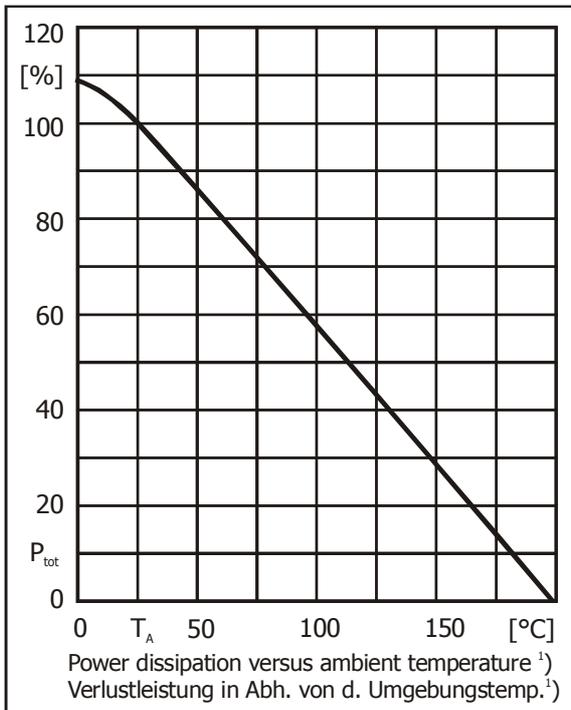
Gemessen mit Impulsen I_R = 100 μA, t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 0.1\text{ A}$	V_F	< 1.0 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	< 100 nA < 15 μA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 30\text{ mA}$ through/über $I_R = 30\text{ mA}$ to $I_R = 1\text{ mA}$		t_{rr}	< 50 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 300 K/W ¹⁾



1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden